



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110823001

2011 年 8 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA REF32xxファミリー製品 チップ一部改定/データシート変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☒ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	HPA REF32xxファミリー製品 チップ一部改定/データシート変更 現行： チップレビジョン Rev. G 変更後：チップレビジョン Rev. J			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	データシートの変更は8月中旬に実施済みです。 12月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) REF32xxファミリー製品について、製品性能向上及び最適動作条件明確化の為に、チップレビジョンを現行 Rev. G からRev. J にチップを一部改訂し認定しました。データシート電気的特性値の変更はありません。また、データシート記載を下記の通り変更しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
チップレビジョン

現行
Revision G

変更後
Revision J

理由：製品性能向上及び最適動作条件明確化の為

対象製品リスト

対象製品名				
REF3212AIDBVR	REF3220AIDBVTG4	REF3230AIDBVRG4	REF3233AMDBVREP	V62/07602-02XE
REF3212AIDBVRG4	REF3220AMDBVREP	REF3230AIDBVT	REF3233AMDBVREPG4	V62/07602-03XE
REF3212AIDBVT	REF3225AIDBVR	REF3230AIDBVTG4	REF3240AIDBVR	V62/07602-04XE
REF3212AIDBVTG4	REF3225AIDBVRG4	REF3230AMDBVREP	REF3240AIDBVRG4	V62/07602-05XE
REF3212AMDBVREP	REF3225AIDBVT	REF3230AMDBVREPG4	REF3240AIDBVT	V62/07602-06XE
REF3212AMDBVREPG4	REF3225AIDBVTG4	REF3233AIDBVR	REF3240AIDBVTG4	
REF3220AIDBVR	REF3225AMDBVREP	REF3233AIDBVRG4	REF3240AMDBVREP	
REF3220AIDBVRG4	REF3225AMDBVREPG4	REF3233AIDBVT	REF3240AMDBVREPG4	
REF3220AIDBVT	REF3230AIDBVR	REF3233AIDBVTG4	V62/07602-01XE	

詳細:

本チップ一部改訂により、特に、最低温度条件-40℃において、スタートアップの安定度が向上します。データシート電気的特性値の変更はありません。本変更により、対象製品のいかなる暫定出荷制限も解除されます。

1. Datasheet# REF32xx SBVS058B → SBVS058C
<http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ref3225.html>

Item	Page/Location	Description of Change
C.1	Page 13, REVISION HISTORY	Revised revision history from Rev-B to Rev-C.

C.1 Pg 13. REVISION HISTORY

REVISION HISTORY

NOTE: Page numbers for previous revisions may differ from page numbers in the current version.

Changes from Revision B (February 2006) to Revision C	Page
• Added Pin Descriptions table	2
• Added note to Enable/Shutdown parameter	4
• Changed the minimum voltage for Enable/Shutdown with reference active from $(0.75 \times V_{IN})$ to 1.5	4
• Changed Current test condition from from $(0.75 \times V_{IN})$ to (1.5V)	4
• Added text, two tables, and one figure to Supply Voltage section	8
• Changed pin 3 in Figure 24 from SHDN to ENABLE (typo)	10
• Added paragraph to Load Regulation section	10

変更内容の詳細はデータシートを参照下さい。上記記載の REVISION HISTORY において各変更箇所へのハイパーリンクが施されています。

製品表示

この変更に伴い、チップレビジョン、出荷ラベル記載のチップレビジョンが下記のように変更されます。

	チップレビジョン (2P)
現行	G
変更後	J



図1 出荷ラベル記載箇所の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験			
信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	—	終了 2011 年 2 月 21 日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	REF3225AIDBV	-	-
Wafer Fab Site:	TSMC-WF2	Wafer Fab Process:	0.6UM DPDM
Passivation:	SiO2/Si3N4 (2kA/7kA)	Metallization:	Ti(0.4kA)/TiN(1kA)/AlCu(4kA)/
Assembly Site:	CARSEM-M (CAR)	Package/Code/Pins:	SOT/DBV/6
Mount Compound:	434165	Mold Compound:	31922001
Bond Wire:	1.0 mil, Au	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails
Electrical Characterization	Full Temp & Voltage range		Approved
ESD - HBM	2000V		3/0
ESD - CDM	500V		3/0
Latch-up	per JESD78		6/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		Approved